

証券コード：6599

**EBRAIN** エブレン株式会社

The background of the slide is a futuristic cityscape with a blue and white color scheme. The buildings are stylized and appear to be constructed from circuitry or data lines. A bright light source is visible in the upper right quadrant, creating a lens flare effect. The word "EBRAIN" is prominently displayed in the center in a bold, red, sans-serif font.

**EBRAIN**

2025年3月期（第52期）  
第1四半期決算説明会資料

- 会社概要
- 事業内容の説明
- 2025年3月期(第52期)第1四半期決算状況
- 2025年3月期(第52期)通期見通し
- 成長への取り組み

設	立	1973年（昭和48年）10月		
本	社	東京都八王子市石川町		
資	本	金	1億4,301万円	
売	上	高	39億8,700万円（2024年3月期）	
経	常	利	益	4億9,000万円（同上）
従	業	員	数	121名（2024年3月現在）
事	業	所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区	
子	会	社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）	
事	業	内	容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、  
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および  
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、  
コントローラーとして使用される**産業用コンピュータ**の  
**受託設計と受託生産**が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、  
**大手の装置メーカーが主契約者**となっていて、私どものビジネスのポジシ  
ョンとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、  
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、  
私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作って装置  
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

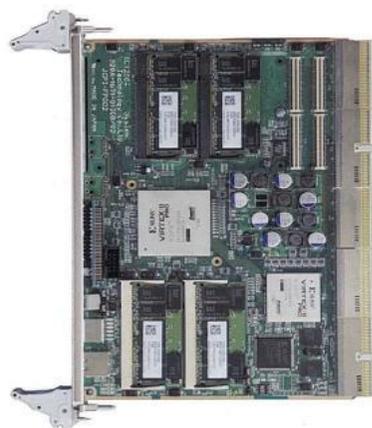


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、  
**量産開始以降は中長期的に安定した製品供給**を要求されます。

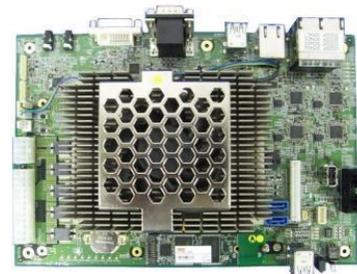
半導体製造装置



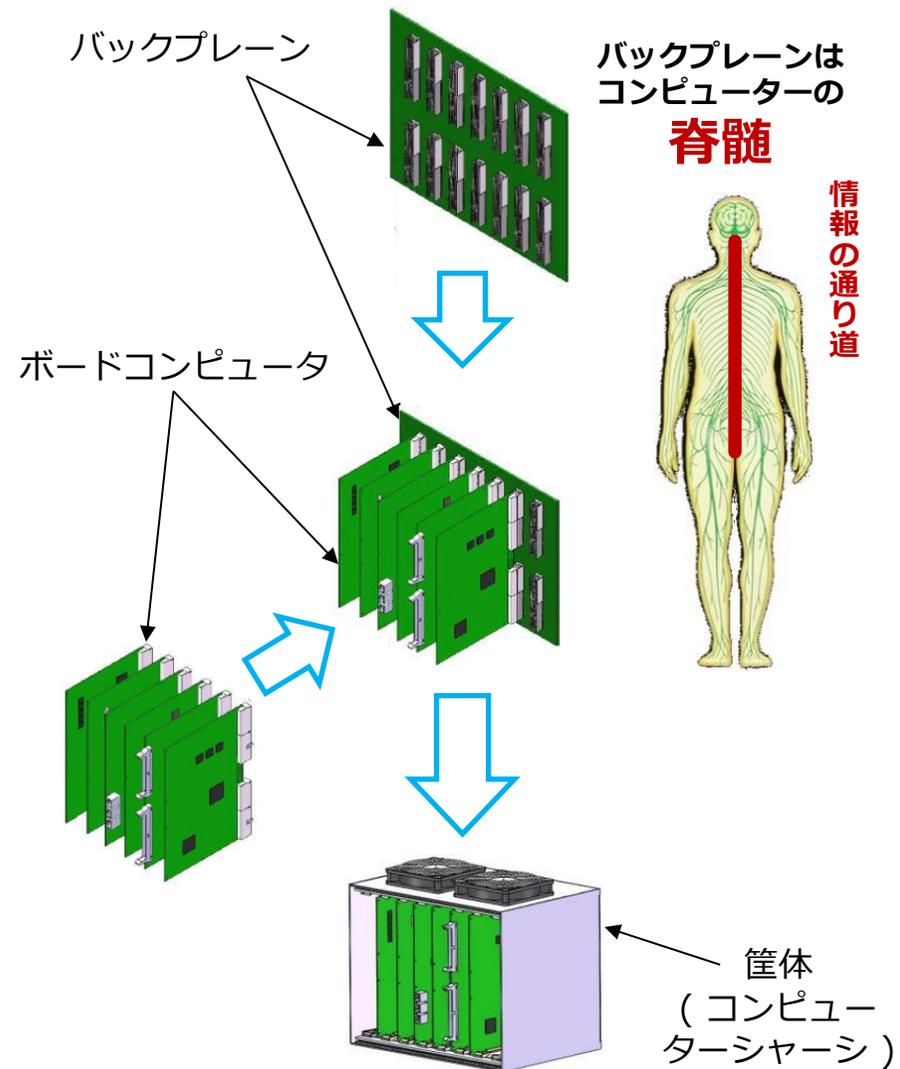
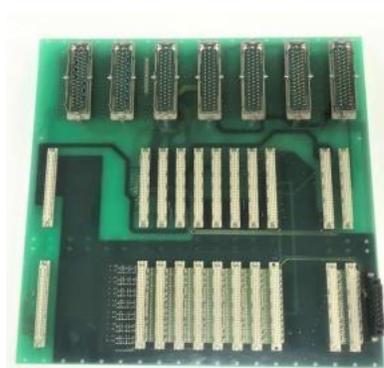
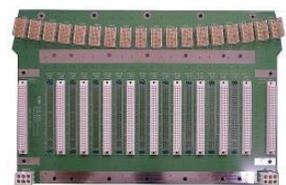
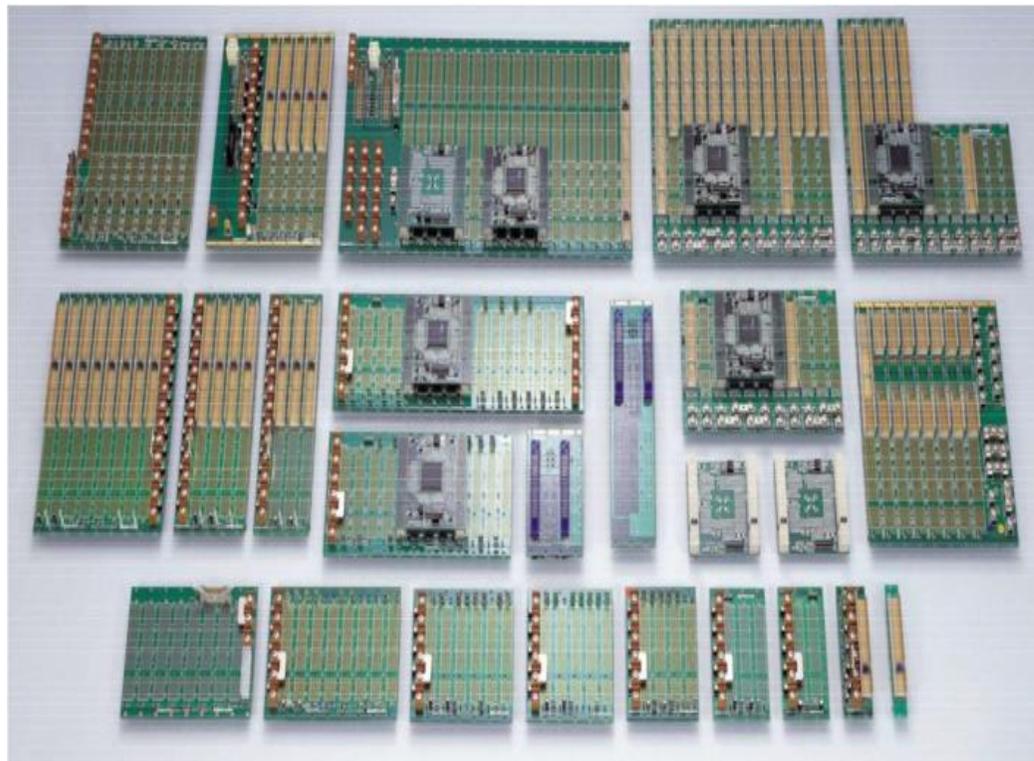
- バックプレーンシステム用  
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用  
ワンボードコンピュータ



# 製品区分(2) バックプレーン

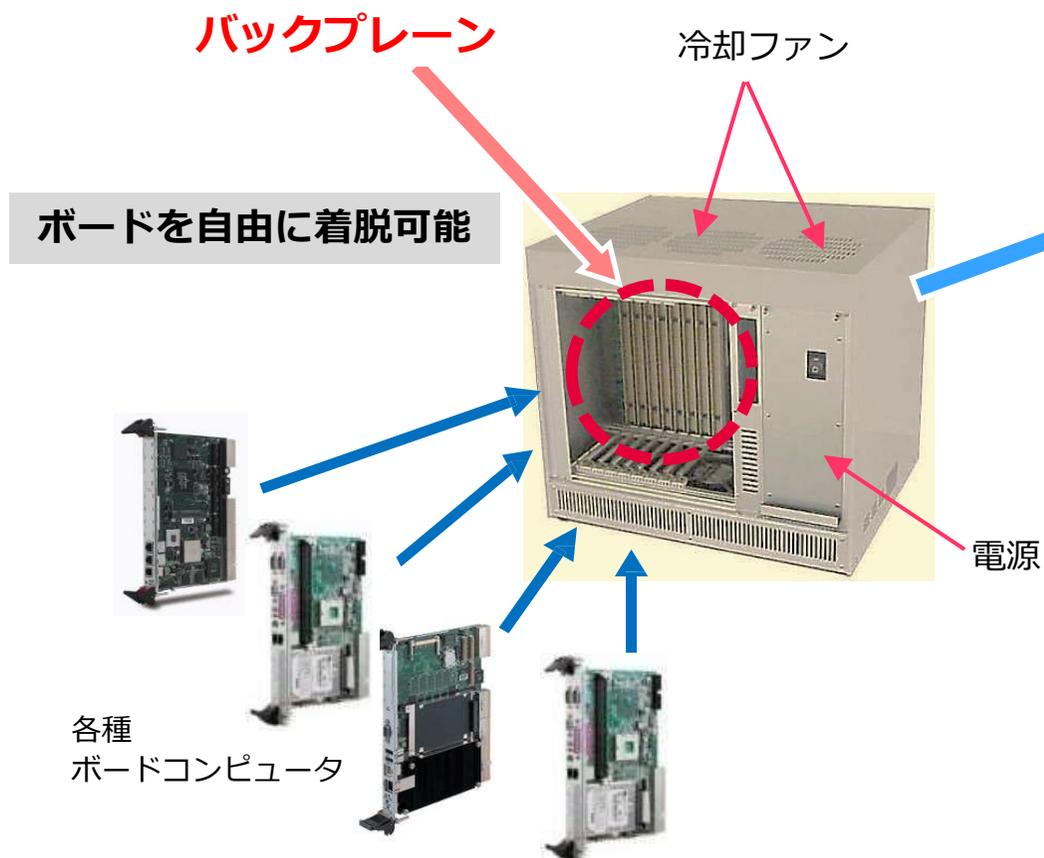


- バスラック  
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ  
(IoT・Edgeシステム用)





(例・半導体製造装置)

## バックプレーン

【役割】  
各種回路基板を相互に接続して  
信号伝送や電力供給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

電源



ボードコンピュータ

## 【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

### 1. 保守性

ホットスワップ、  
保守体制、保守要員、

### 2. 拡張性

拡張スロット、増設、  
機能追加、

### 3. 汎用性

市場に流通しているボードコンピュータ  
を採用する事が可能。

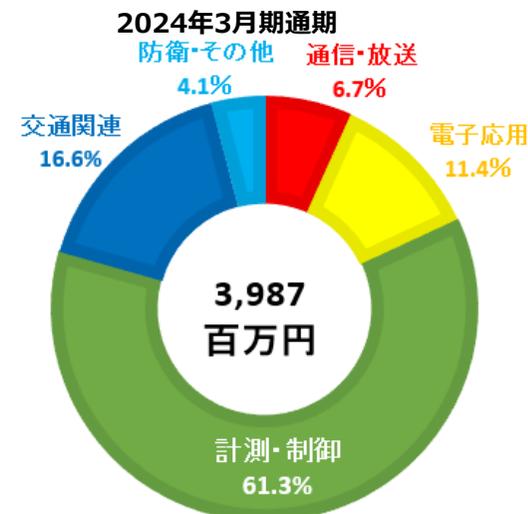
多くの産業用コンピュータで  
バックプレーン方式が採用される

# エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



## 連結売上高構成前年同期比



# 主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

## 各分野の主要メーカーへ納入

**NEC**

NEC グループ各社

**HITACHI**  
Inspire the Next

日立製作所  
グループ各社

**FUJITSU**

富士通グループ各社

**住友電工**  
Connect with Innovation

住友電気工業 (株)

**GE** Healthcare

GE Healthcare  
グループ各社

**Preferred Networks**

(株) プリファード・  
ネットワークス

**三菱重工**

三菱重工  
グループ各社

**MITSUBISHI ELECTRIC**

三菱電機  
グループ各社

**Kawasaki**

川崎重工業  
グループ各社

**TEL**

東京エレクトロン  
グループ各社

**Canon**

キヤノンメディカル  
システムズ (株)

**古河電工**

古河電気工業 (株)

**KYOSAN**

(株) 京三製作所

**viswill**

第一実業ビスウィル (株)

**Panasonic**

パナソニック  
グループ各社

**TOSHIBA**

東芝 グループ各社

**Lasertec**

レーザーテック (株)

**OLYMPUS**

オリンパスメディカル  
システムズ (株)

**Nikon**

(株) ニコン

**SCREEN**

(株) SCREENセミコンダクター  
ソリューションズ

**日本信号株式会社**

日本信号 (株)

**SONY**

ソニーグローバル  
マニュファクチャリング&  
オペレーションズ

**MEIDEN**

(株) 明電舎

**TOKYO KEIKI**

東京計器 (株)

**Anritsu**

アンリツ (株)

**SAMSUNG**

サムスン電子  
グループ各社

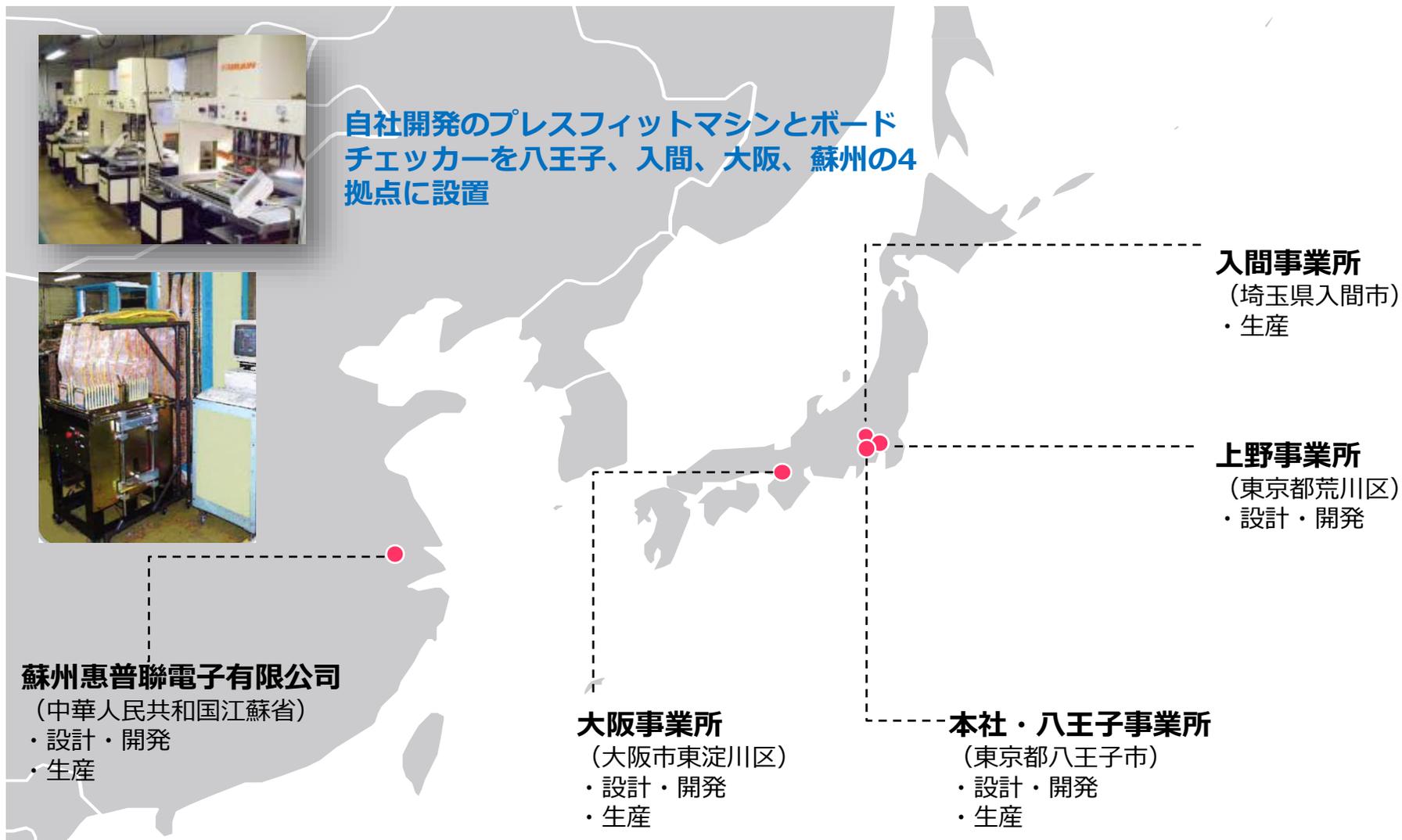
**USHIO**

ウシオ電機 (株)

**ONO SOKKI**

(株) 小野測器

## BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産

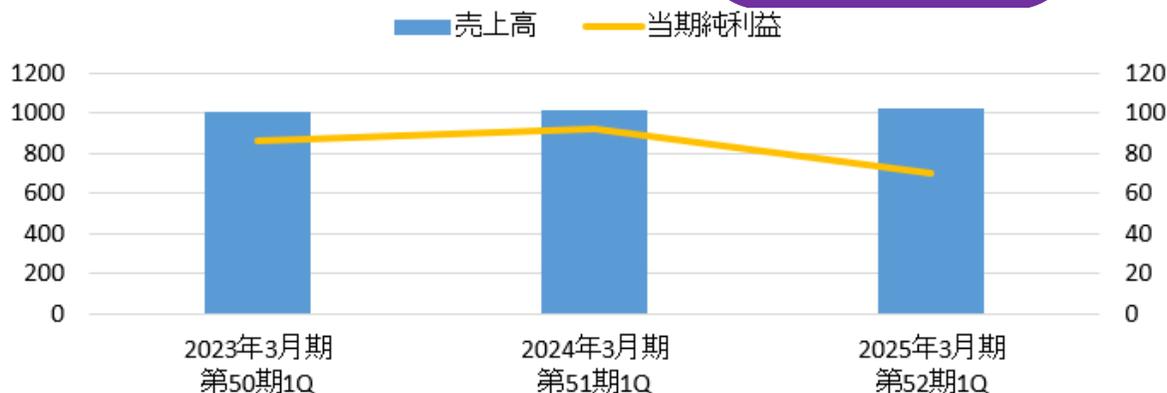




**2025年3月期（52期）  
第1四半期業績報告**

# 2025年3月期（第52期） 第1四半期決算実績

連結損益計算書	2023年3月期 第1四半期	2024年3月期 第1四半期	2025年3月期 第1四半期	52期計画 (進捗率)
売上高	1,003	1,012	<b>1,020</b> (100.7%)	4,100 (24.8%)
営業利益	147	145	<b>111</b> (76.8%)	530 (20.9%)
営業利益率	14.7%	14.3%	10.8%	
経常利益	138	146	<b>110</b> (75.4%)	530 (20.7%)
経常利益率	13.8%	14.4%	10.7%	
当期純利益	86	92	<b>70</b> (76.8%)	350 (20.0%)
当期純利益率	8.6%	9.1%	6.7%	



単位：百万円



## 計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ 顧客の在庫増加による生産調整
- ✓ 中国向けレガシー装置の需要は旺盛も当社には影響ほとんど無し
- ✓ 高利益品の生産調整による生産減少
- ✓ 前年同期比**6.2%減**

634百万円→595百万円 (39百万円↓)



## 交通関連

- ✓ 鉄道信号関連の新規案件の量産開始
- ✓ 売上は前年同期比**41.0%増**

159百万円→224百万円 (65百万円↑)



## 通信・放送

- ✓ 通信分野のメイン機種が生産終息
- ✓ 電力関連は堅調に推移
- ✓ 売上は前年同期比**37.4%減**  
74百万円→46百万円 (27百万円↓)



## 電子応用

- ✓ 一時的な生産調整による生産減少
- ✓ 売上は前年同期比**6.2%増**  
118百万円→111百万円 (7百万円↓)

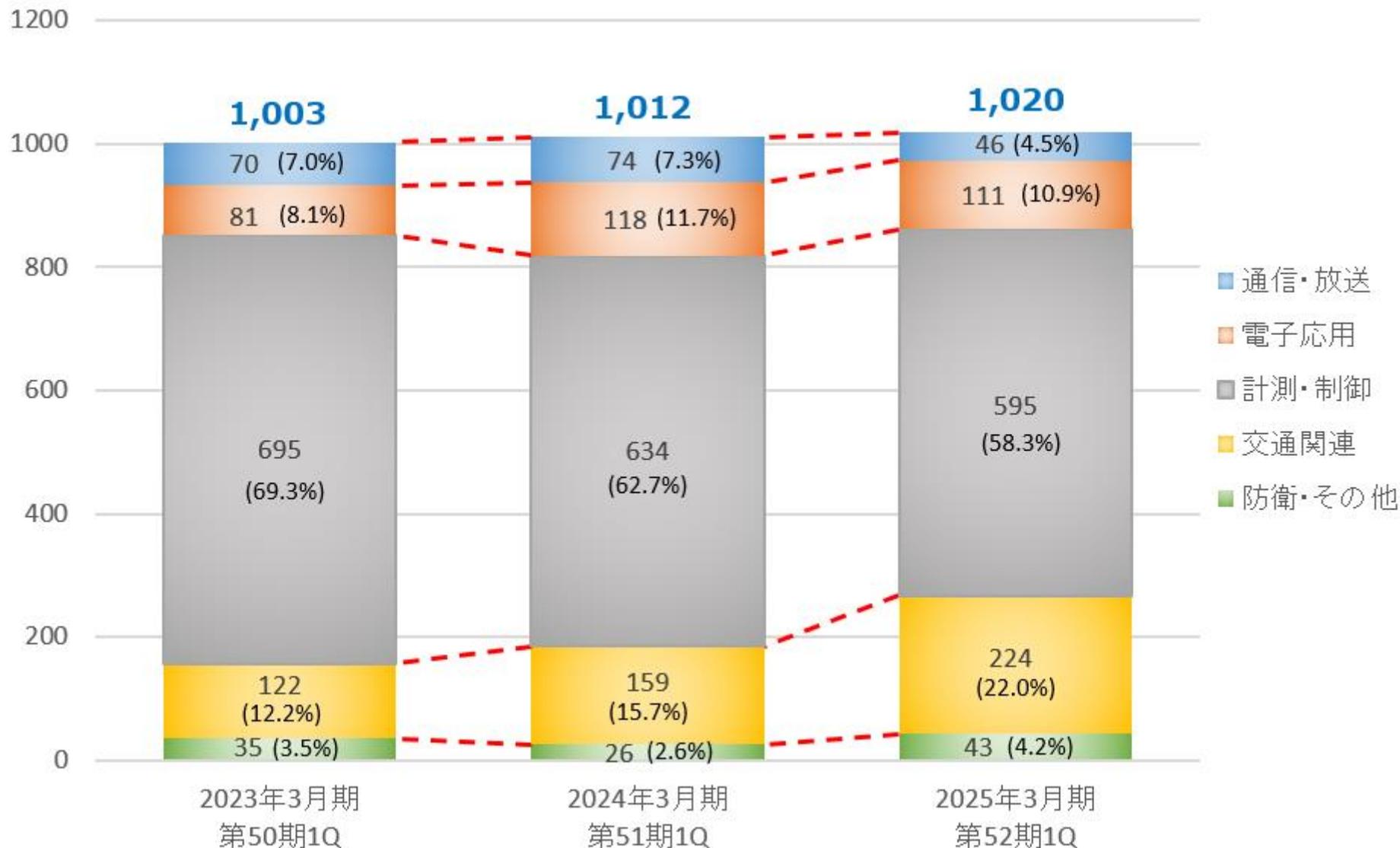


## 防衛・その他

- ✓ 売上は前年同期比**63.8%増**  
26百万円→43百万円 (16百万円↑)

連結応用分野別売上同四半期推移

単位:百万円

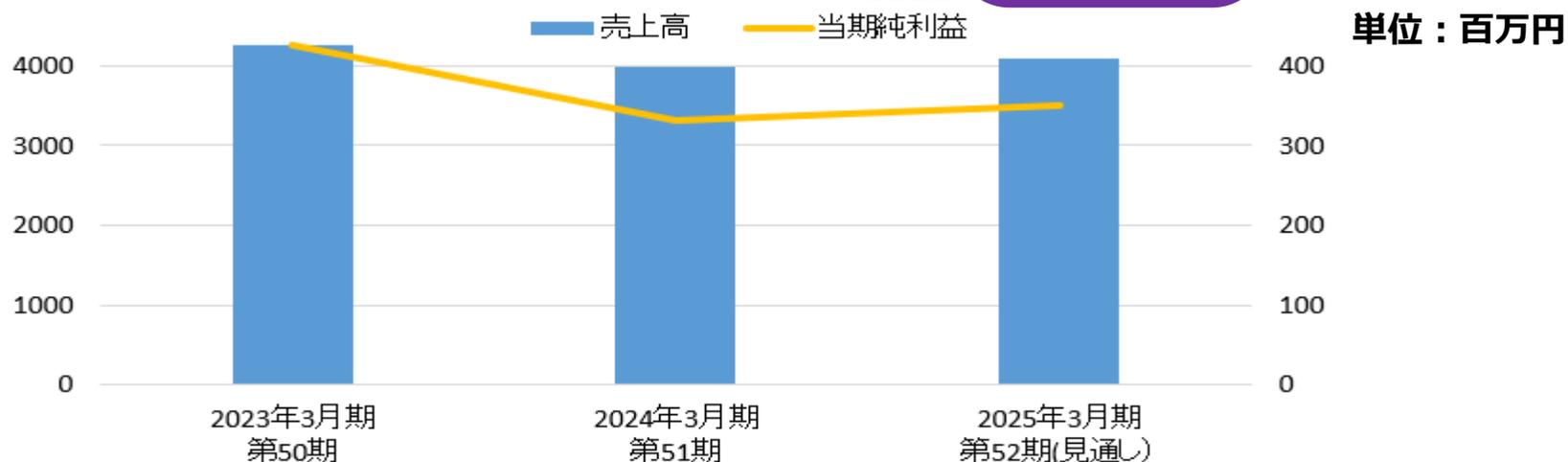


	2024.3 (百万円)	2024.6(1Q) (百万円)	前期末比
流動資産	4,407	<b>4,463</b>	<b>101.3%</b>
固定資産	1,267	<b>1,272</b>	<b>100.4%</b>
資産合計	5,674	<b>5,736</b>	<b>101.1%</b>
流動負債	771	<b>796</b>	<b>103.2%</b>
固定負債	401	<b>403</b>	<b>100.5%</b>
負債合計	1,172	<b>1,199</b>	<b>102.3%</b>
純資産	4,502	<b>4,536</b>	<b>100.8%</b>
負債純資産合計	5,674	<b>5,736</b>	<b>101.1%</b>
自己資本比率	79.3%	<b>79.1%</b>	<b>-0.2%</b>

# 2025年3月期 (第52期) 通期予想

連結損益計算書	2023.3 50期	2024.3 51期	2025.3 52期見通し	増減率
売上高	4,258	3,987	<b>4,100</b>	102.8%
営業利益	656	486	<b>530</b>	109.0%
営業利益率	15.4%	12.1%	<b>12.9%</b>	
経常利益	654	490	<b>530</b>	108.1%
経常利益率	15.3%	12.2%	<b>12.9%</b>	
当期純利益	426	332	<b>350</b>	105.4%
当期純利益率	10.0%	8.3%	<b>8.5%</b>	
1株当たり配当	27円	33円 + 5円※	<b>40円</b>	

※50周年記念配当



## 主要顧客の生産調整が続く、客先により状況はまちまち



### 計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ 顧客の在庫増による生産調整継続
- ✓ 下期から生産調整解消を見込む



### 交通関連

- ✓ 鉄道信号系新規案件量産開始
- ✓ 開発案件増加傾向

## 主要顧客の生産調整が続く、客先により状況はまちまち



### 通信・放送

- ✓ 通信関連メイン機種が生産終息
- ✓ 電力分野の案件は堅調に推移



### 電子応用

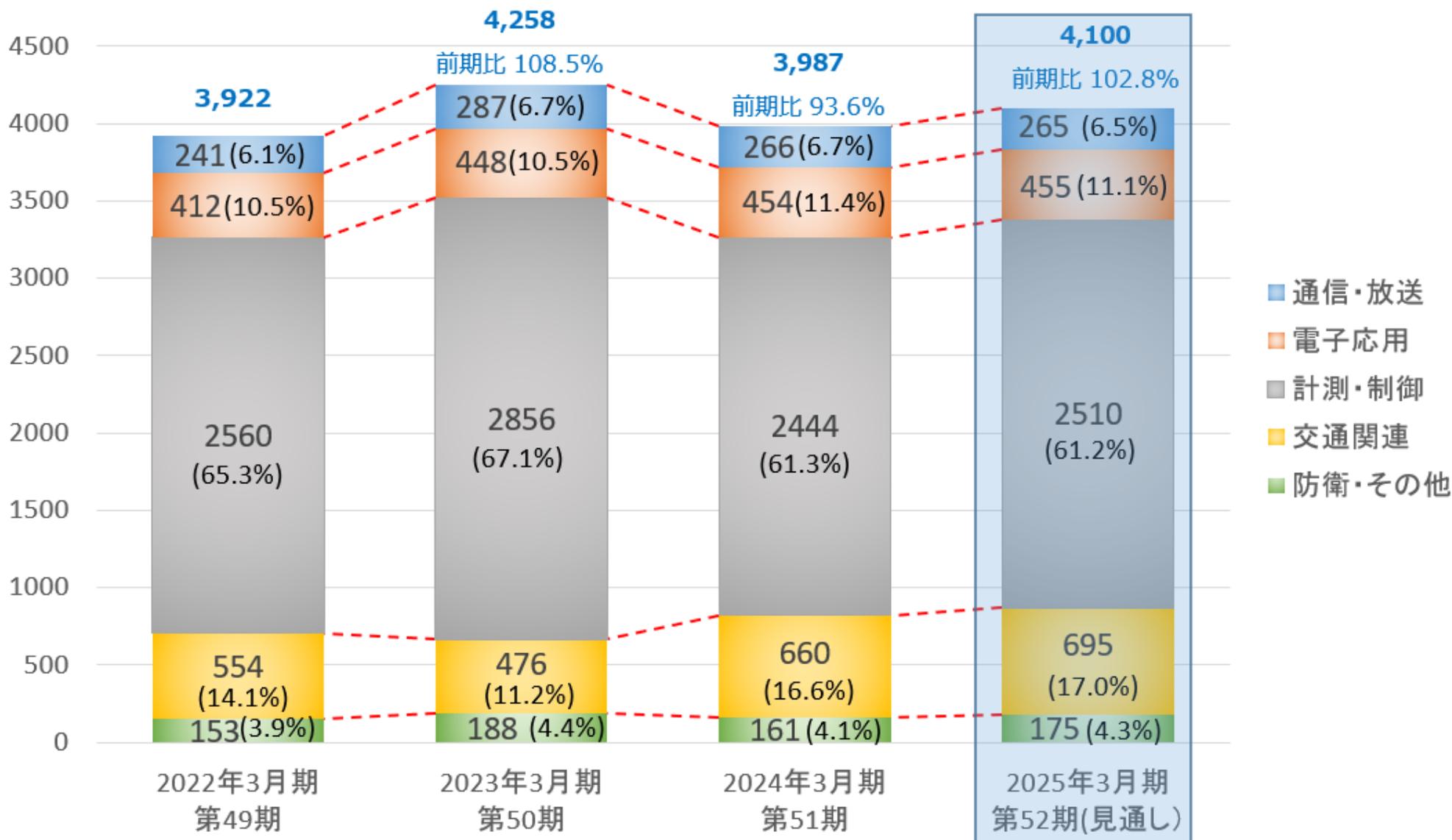
- ✓ 一時的な生産調整による生産量減少
- ✓ 医療器関連の生産が多い中国子会社の中国経済状況悪影響懸念



### 防衛・その他

- ✓ 今期も例年並みを予想

# 2025年3月期 (第52期) 応用分野別売上予想



証券コード：6599

**EBRAIN** エブレン株式会社

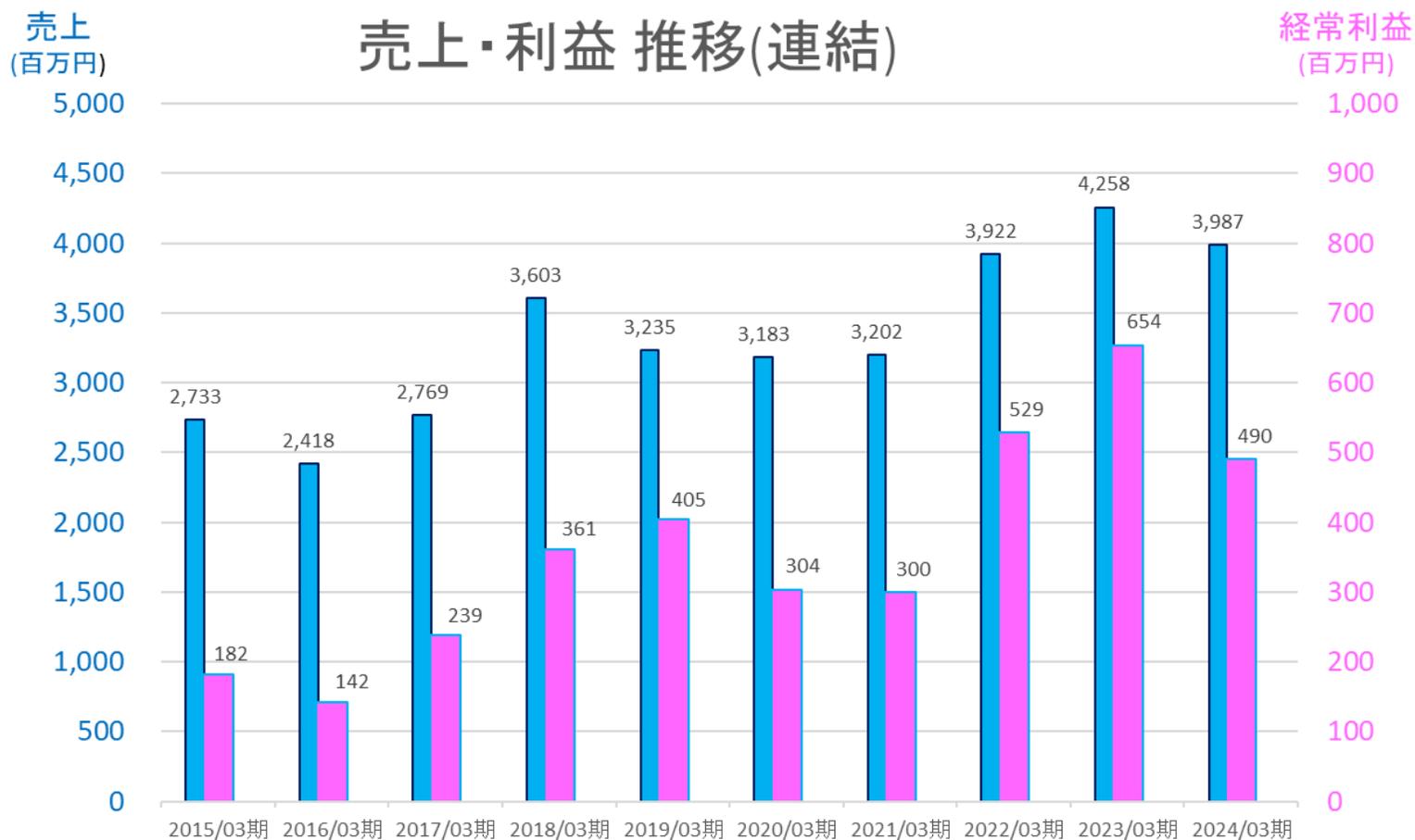


**成長への取り組み**

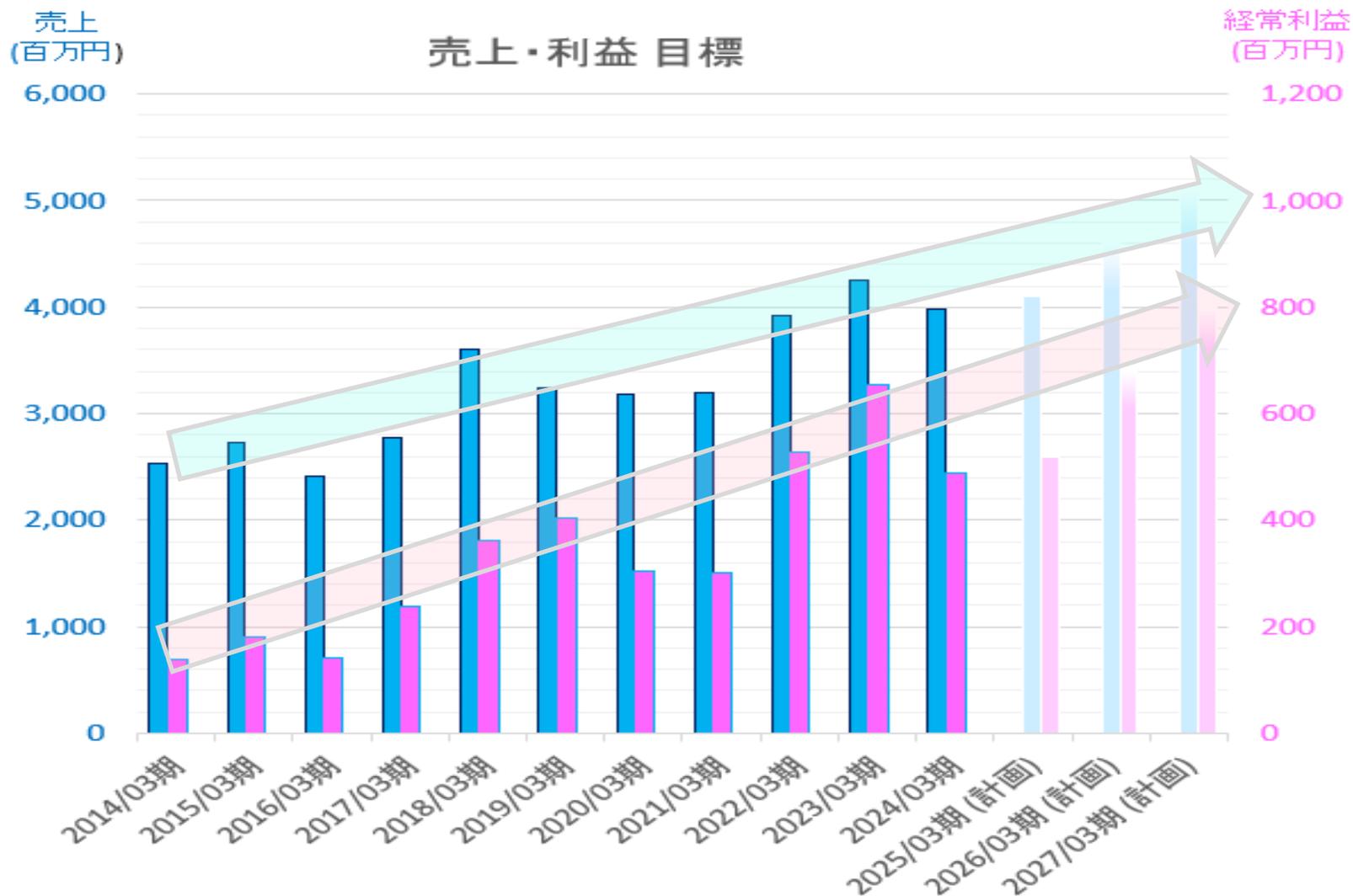
# 直近10年間の業績推移

売上：27.3億円→39.8億円

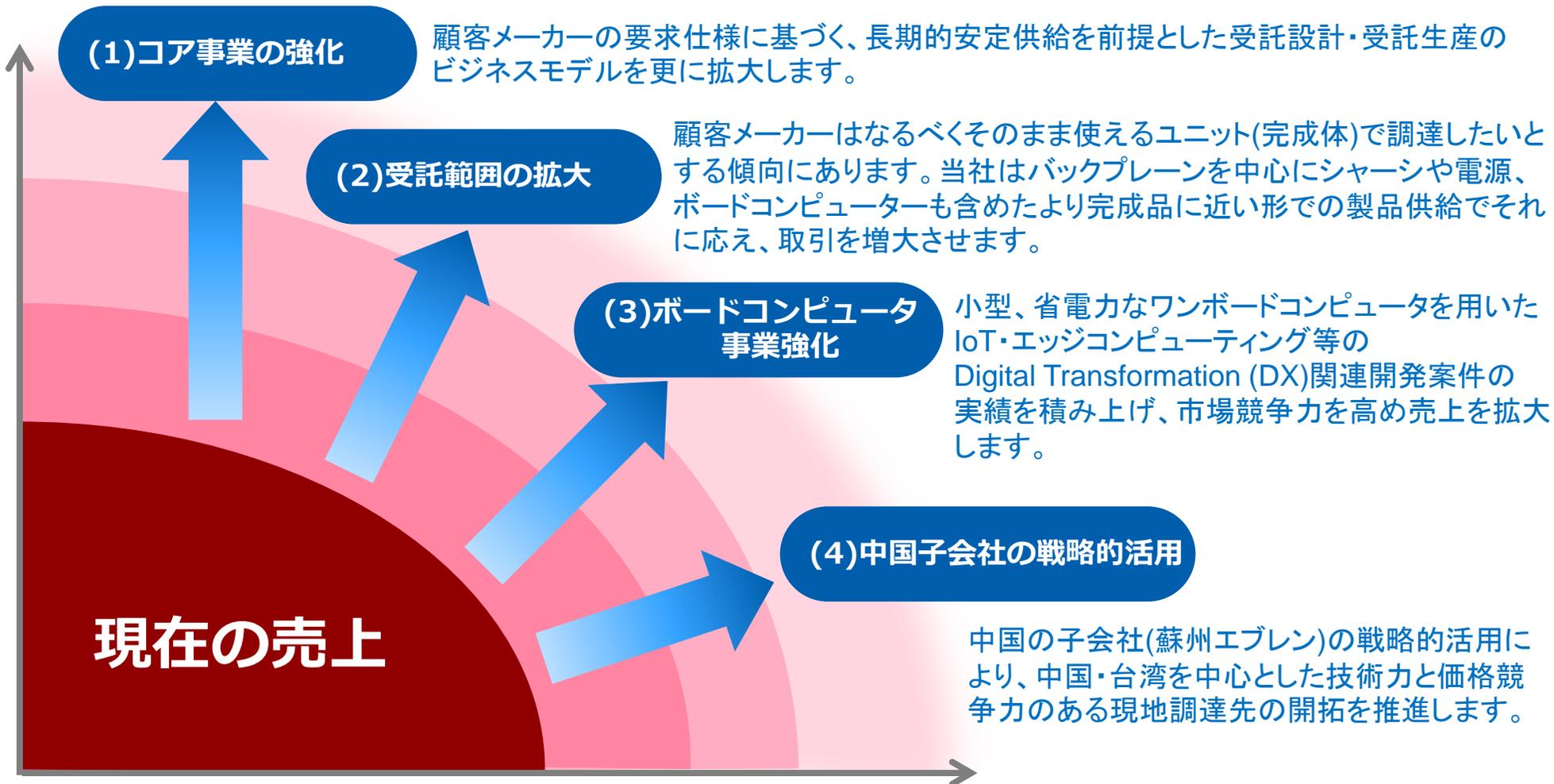
経常利益：1.8億円→4.9億円



年率10%~15%成長を目標として成長路線を堅持  
2027年3月期（54期）に売上51億円、経常利益8億円を目指す



## より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



# (1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての優位性（**短納期・低コスト・高品質**）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積

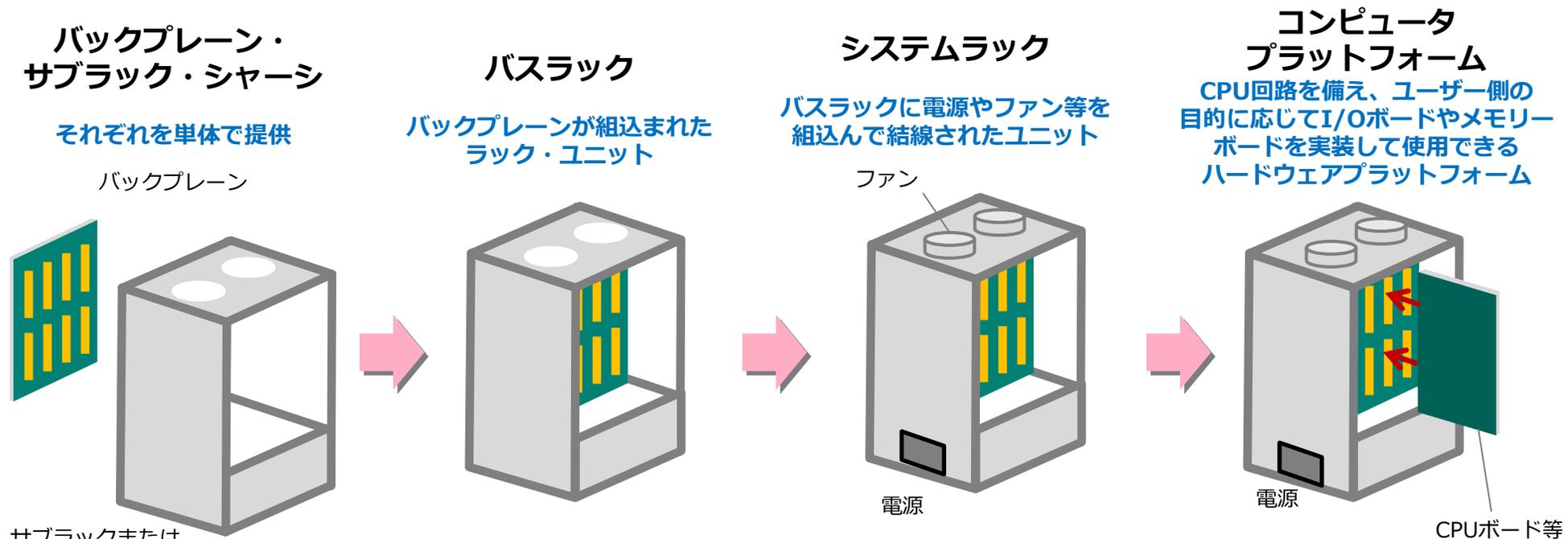
- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充（**冷却構造、耐電磁波構造等**）
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充（**FANアラームボード、標準部材等**）
- ・生産拡大に伴う生産設備増強

市場における優位性増大 = 事業拡大へ

## (2) 受託範囲の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。



年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

受託範囲の拡大による業績拡大

### (3) ボードコンピュータ事業強化

技術革新で小型化・低消費電力化が進み、エッジコンピューティング、IoT等、小型ワンボードコンピュータを使用して実現するDX (Digital Transformation)関連の開発案件が増加している。

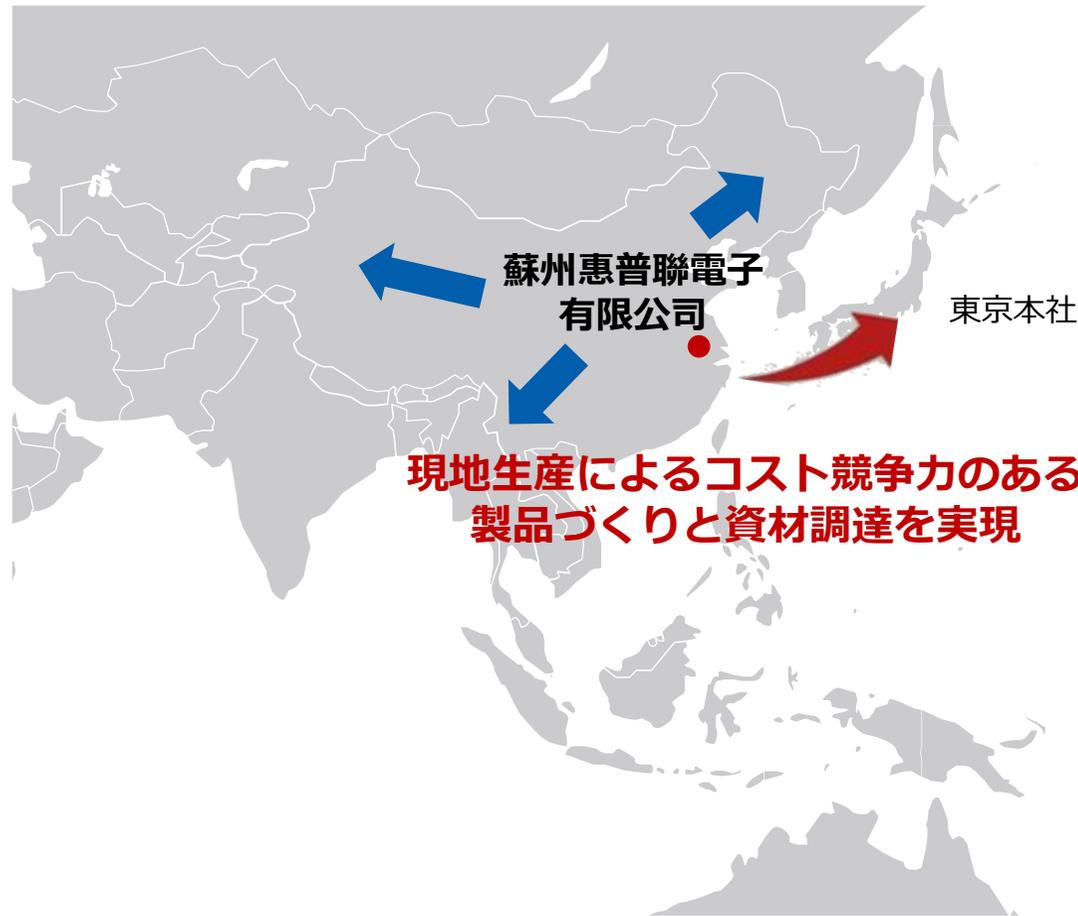
6月に設計・製造会社と業務提携を締結。パートナーシップを含む技術部門の増強を図り製品開発力の向上を目指す。

- ・ 高電圧・大容量直流遮断器（洋上風力発電向送電用途）
- ・ 半導体検査用制御装置（マイクロプロセッサ用途）
- ・ 次世代ワイヤードンダーコントローラー（システム制御）
- ・ 省エネ型スーパーコンピューター（AI用途）
- ・ AI画像処理システム（監視カメラ用途、FAカメラ用途等）
- ・ ショットピーニング用AEセンサーモジュール（FA用途）
- ・ 半導体製造装置用制御部（露光装置用途）
- ・ 光学特性検査システム（医療用途）

※現在進行中の開発案件抜粋

## (4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司  
概要

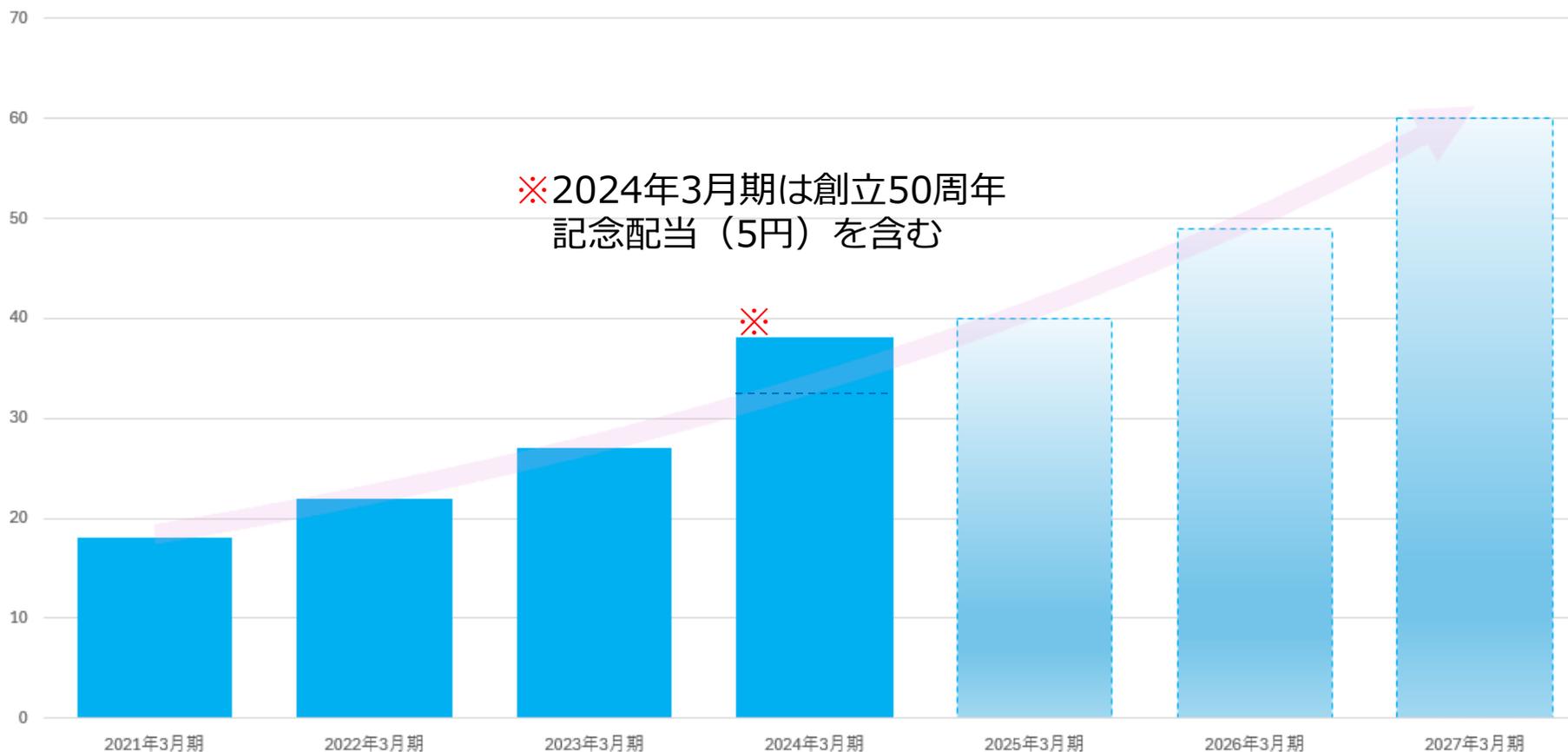
会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

## 安定した増配を継続

2020年の上場以来毎年22%の増配を継続しています。

2023年10月22日には創立満50年を迎え、2024年3月期は記念配当として5円上乗せ配当を実施しました。今後も安定した増配を継続する方針です。

1株当たり配当額



注) 上記グラフは22%増配を継続した場合のグラフです。実際の配当額は業績等を勘案して決定します。この配当をお約束するものではありません。

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

**EBRAIN**